

## Plaskon SMT-B-1

Епоху; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

### Описание материалов:

This material is an epoxy molding compound designed specifically for grid arrays (BGA/LGA). It is formulated with a unique resin system, which minimizes warpage and enables trouble-free molding onto rigid and flexible laminate substrates. Minimal dimensional change after molding, post bake and subsequent solder treatment make this compound an excellent choice for grid arrays.

Главная Информация			
Характеристики	Полупроводникового Хорошая стабильность размеров Низкий уровень защиты Высокотемпературная прочность		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.86	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.050	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль			ASTM D790
22°C	1.38	MPa	ASTM D790
215°C	0.824	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
22°C	0.0103	MPa	ASTM D790
215°C	0.00363	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	225	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.4E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.70	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	16	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	4.00		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0		UL 94
Индекс кислорода	34	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			

Recommended Storage Temperature: <5°C  
Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 24 months  
Life @ 21°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 8 days  
Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 3 days  
Spiral Flow, 175°C, 1000 psi: 77 cm  
Shimadzu Viscosity, 175°C, 1000 psi: 88 poise  
Ram Follower Gel Time, 175°C, 1000 psi: 19 sec  
Ash Content: 77.4 %  
Hydrolyzable Halides: <1 ppm  
Cull Hot Hardness, Shore D: 73  
Volume Resistivity, 22°C: 1e15 ohm-cm  
Volume Resistivity, 150°C: 1e12 ohm-cm  
All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C  
Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 14 cm<sup>-6</sup>/cm/°C  
Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 58 cm<sup>-6</sup>/cm/°C

## Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Molding Temperature: 170 to 185°C

Molding Pressure: 750 to 1250 psi

In Mold Cure Time: 120 to 180 sec

Post Mold Cure Time, 175°C: 4 to 6 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat